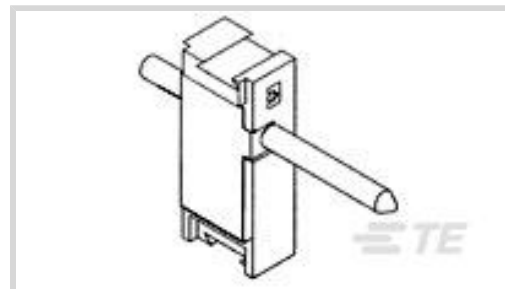




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **导轨硬件**

连接器硬件附件类型: **导针模块**

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	导轨硬件
连接器硬件附件类型	导针模块

包装特性

封装数量	10
封装方法	Bag

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | ELCON Domino



矩形电源连接器(4)



连接器硬件(11)

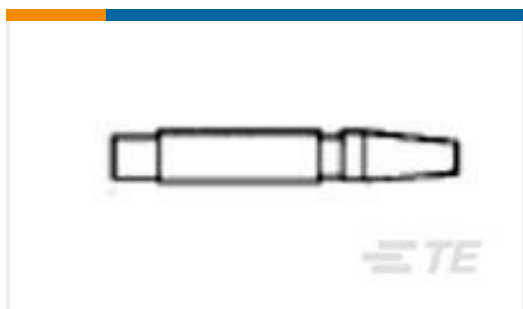
客户还购买了



TE 产品编号1630019-9
HSC200 1K5 5%



TE 产品编号2178410-1
CROWN CLIP JUNIOR CONN



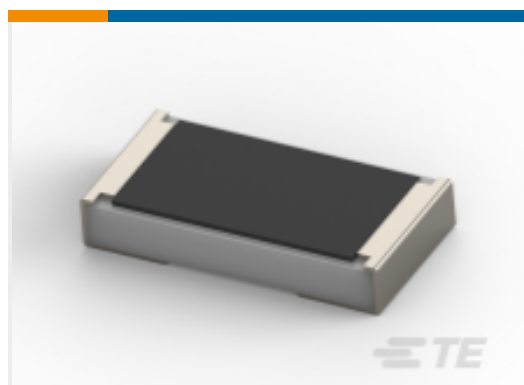
TE 产品编号207597-1
PLUG, TYPE XII KEYING



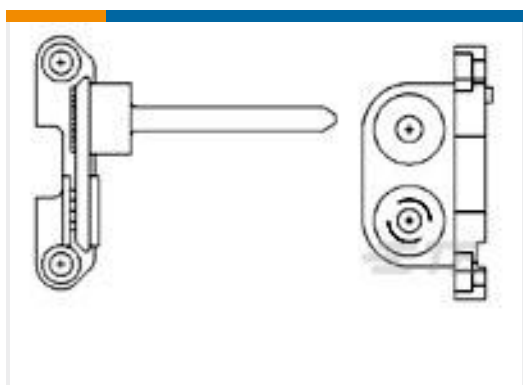
TE 产品编号8-1614882-8
CPF 0603 7R5 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2176445-1
HCF216 200W 10R 5% LEAD



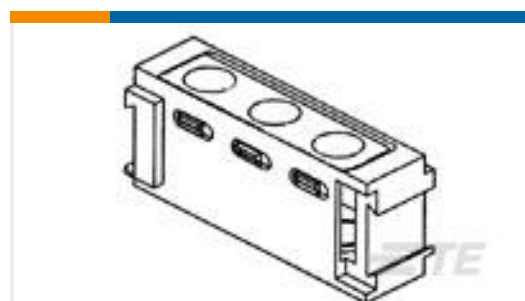
TE 产品编号2176468-5
TLRP 2010 1.0W R068 1% 75PPM 4K RL



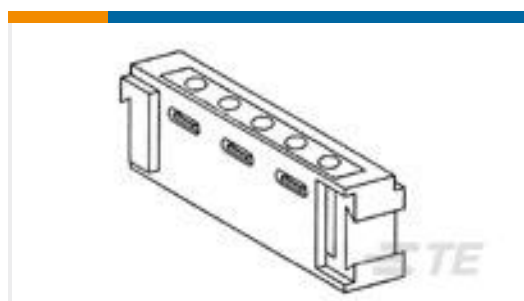
TE 产品编号6648251-1
GUIDE PIN,FLOAT MNT,END CAP,
DOMINO



TE 产品编号1648463-1
765-12-0080C=TA HSG,PIN,MOD C



TE 产品编号1648461-1
765-10-0080A=TA HSG,PIN,A MOD



TE 产品编号1648464-1
765-13-0080D=TA HSG,PIN,D MOD

文档

产品图纸

MODULE,DOMINO

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648508-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648508-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6648508-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本